GaN基板上AIGaN/GaN HEMTの素子特性に バッファ層へのCまたはFeドーピングが及ぼす影響

Effect of C or Fe doping to buffer layer on performance of AlGaN/GaN HEMT on GaN substrate

豊田工業大学, ⁰(M2)近藤 孝明, (B)東中川 洋幸, 岩田 直高

Toyota Technological Institute, °Takaaki kondo, Hiroyuki Higashinakagawa, Naotaka Iwata

E-mail: sd18414@toyota-ti.ac.jp

AlGaN/GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT)は、低オン抵抗と高耐圧特性を示し、電 力制御への利用が期待されている.一般に AlGaN/GaN HEMTはSiやSiC基板上に作製される が、基板とGaNの格子不整合による結晶欠陥が生 じる.そのために厚いバッファ層が欠かせないば かりではなく、本来の特性が示せていない.そこ で、GaN基板上のAlGaN/GaN HEMTが注目されて いる[1].現在、GaNバッファ層の絶縁性を得るた めには不純物のドーピングが一般的である.しか し、このドーピングがHEMTの特性へ与える影響 は明らかにされていない.本研究の目的は、GaN バッファ層へのドーピングが素子特性に及ぼす 影響を明らかにすることである.

使用したウエハは、Al_{0.22}GaN/GaN/GaNバッファ構造をGaN基板上に形成したものである. GaNバッファ層へ炭素をドーピングしたCドープ 素子と,鉄をドーピングしたFeドープ素子を検討 した.素子の作製プロセスを以下に示す.ウエハ 上へSiO₂/SiN膜を堆積した後,ドライエッチング による素子分離を行った.次にAu/Ti/Al/Ti構造の オーミック電極を形成し,合金化熱処理を施した. その後Au/Ni構造のゲート電極を形成した.最後 にSiN膜を原子層堆積法により堆積した.

試作したHEMTの電子移動度は1900cm²/V・sで あり、Si基板上の移動度よりも高い[2]. これは、 GaN基板上HEMTチャネルの結晶欠陥密度がSi基 板上よりも低く、電子の散乱が少ないことを示唆 する.次に、トランジスタ特性を測定したところ、 ドレイン電流(*I*₀) 480mA/mmをCドープ素子で、 400mA/mmをFeドープ素子で得た. なお、しきい 値電圧はともに-1.5Vであった. 続いて、バッファ 層からチャネルに変調をかけて、ドーピングの影 響を評価した. Fig.1に、サイドゲート構造を持つ HEMTの断面図と上面写真を示す. サイドゲート は、素子領域を取り囲むようにバッファ層の上部 に形成した. Fig.2に、ドレイン電圧(V_{DS})6.0Vを印 加した状態で、サイドゲートと接地間に負から正 のバイアス電圧を掃引したときの I_D 特性を示す. ソースとゲートは接地した. Cドープ素子では、 サイドゲート電圧の掃引に伴って I_D が上昇した. そして、サイドゲート電圧が-8V付近でゲート電 圧(V_{GS})0Vを印加したHEMTの I_D とほぼ等しい値 を示し、それ以降は一定となった. 一方Feドープ 素子は、サイドゲート電圧の値にかかわらず V_{GS} =0Vを印加したHEMTの I_D を示した. すなわち、 Cドープ素子ではバッファ層を通してチャネル が変調されたのに対し、Feドープ素子は変調され なかった. よって、Feドープバッファ層は外部か らの電圧変動に強いことが判明した.





Fig.1. Structure and top view of HEMT with side gate.

本研究は文部科学省「省エネルギー社会の実現に資す る次世代半導体研究開発」の委託を受けたものです.

T. J. Anderson *et al.*, IEEE EDL **37**, 28 (2016).
T. Kondo *et al.*, JJAP **59**, SAAD02 (2020).

Fig.2. I_D characteristics of the side gate HEMTs.